



軟磁性モールド材料

# 低周波磁気シールド用 射出成形コンパウンド

## 概要

低周波磁気シールド用コンパウンドは、ソフトフェライト粉末や軟磁性メタル粉末を熱可塑性樹脂と混合させた樹脂複合軟磁性材料で、優れた磁気特性と射出成形性を両立しています。高い磁気シールド性を付与したECUやインバータ、バッテリーケースなどの筐体の成形が可能です。また、導電材料と組み合わせることで、さらなる特性の向上も実現できます。

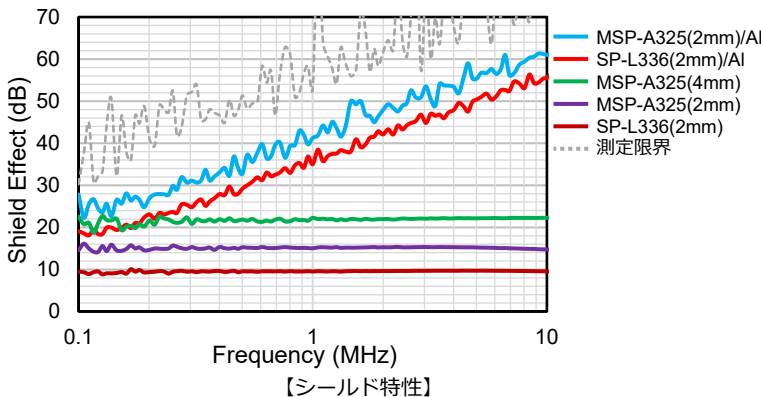
## 特徴

- 1 高透磁率**  
磁性材料を高充填することで、優れた透磁率特性を有しています。
- 2 優れた成形性**  
樹脂複合化に適した特性を有する磁性粉末を使用しており、成形性に優れています。
- 3 顧客の要求に合わせた設計**  
ご希望に応じて樹脂(PP, PBT, PPS, PA12など)およびフィラーの選定が可能です。

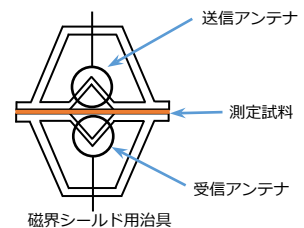
## 製品情報

【代表製品の特性】

品名	SP-L336	MSP-A325	
材質	Mn-Mg-Znフェライト/PP	Fe-Si-Al/PP	
成形密度 (g/cm <sup>3</sup> )	3.6	2.5	
$\mu'$ @100kHz	21	28	
$\mu'$ @10MHz	20	24	
体積固有抵抗 ( $\Omega \cdot \text{cm}$ )	$10^{15} \sim 10^{16}$	$10^{-1} \sim 10^0$	
シールド効果 (dB) @100kHz	Al箔なし	10* <sup>2</sup>	15* <sup>2</sup>
	Al箔あり* <sup>1</sup>	19* <sup>2</sup>	28* <sup>2</sup>



- \*1 Al箔は厚み15 $\mu\text{m}$ のものを使用
- \*2 厚み2mmの試料で測定したデータ
- \*3 厚み4mmの試料で測定したデータ



【KEC法 測定方法】

KEC法(磁界):送受信アンテナの間に測定試料を挟み、磁界の減衰量を評価します。

## 用途

- ECUやインバータなど低周波磁気シールドが必要とされる電子部品の筐体
- ノイズ抑制シート

